

株主メモ

事業年度	毎年8月1日から翌年7月31日まで
定時株主総会	10月
基準日	7月31日
	上記のほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
配当金支払株主確定日	期末配当金 7月31日 中間配当金 1月31日
単元株式数	100株
上場市場	東京証券取引所市場第一部
公告方法	電子公告とし、当社ホームページ (http://www.samco.co.jp/) に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777 (通話料無料) ※株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の三菱UFJ信託銀行の電話及びインターネットでも24時間承っております。 ○電話(通話料無料) 0120-244-479 (本店証券代行部) 0120-684-479 (大阪証券代行部) ○インターネットホームページ http://www.tr.mufg.jp/daikou/

(ご注意)

1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取次ぎいたします。
3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

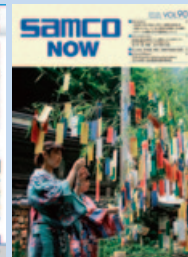
ホームページのご紹介

最新のトピックスをはじめ、財務情報や会社情報を掲載しております。製品・アプリケーションの紹介や広報誌「サムコナウ」など、掲載内容を充実させております。当社をよりご理解いただくためにもぜひアクセスしてください。

<http://www.samco.co.jp/>



トップページ



サムコナウ

samco

samco[®]
サムコ株式会社

証券コード 6387

**BUSINESS
REPORT
2015**

第36期 年次報告書

2014.08.01 ▶ 2015.07.31





平成27年10月
代表取締役会長兼社長 辻 理

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。当社第36期（平成26年8月1日～平成27年7月31日）の報告書をお届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

当期、当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、スマートフォンやタブレット型端末の世界的な需要拡大を背景にした設備投資に加え、当社の関わる化合物半導体を用いた新たなモバイル機器や車載センサーなど先端分野での研究開発投資が、幅広い企業で進みつつあります。台湾や中国、韓国での生産設備投資につきましては慎重な姿勢が続いておりますが、景気回復が続く北米では新たな技術開発、商品化に伴う設備投資が活発化しております。

このような状況の下、国内市場はオプトエレクトロニクス分野の高輝度LEDや、LD（Laser Diode=半導体レーザー）等での大型機、電子部品分野の高周波フィルター、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems=微小電気機械素子）用途で販売を伸ばし、国内売上高は3,861百万円（前期比44.7%増）となりました。海外市場は引き続きアジア市場が中心であり、輸出版売高は1,391百万円（前期比11.0%減）となりました。

以上の結果、当期における業績は、売上高が5,252百万円（前期比24.1%増）、営業利益は671百万円（前期比161.7%増）、経常利益は円安の進行による為替差益158百万円（前期は45百万円）が発生したことから828百万円（前期比183.5%増）となりました。また、特別損失として仲裁裁定に伴う損失を139百万円計上し、当期純利益は417百万円（前期比119.2%増）となりました。また、当期における受注高は6,156百万円（前期比45.4%増）、当期末の受注残高は1,915百万円（前期末比89.3%増）となりました。

第37期の見通しといたしましては、重点分野での販売強化や海外市場の更なる開拓等の施策の推進により、事業計画の達成に努めてまいります。重点分野につきましては、オプトエレクトロニクス分野では、高輝度LED用途やLD用途での需要の継続を見込んでおります。電子部品分野では、スマートフォンやタブレット型端末向け高周波フィルターへの設備投資の需要を確実に受注に結び付けると共に、インクジェットプリンターヘッドや医療、ライフサイエンス、バイオ等のMEMS市場、SiC（炭化ケイ素）やGaN（窒化ガリウム）を使用した次世代パワーデバイス市場向けの販売を促進してまいります。海外市場につきましては、中国、台湾、韓国を中心とする東アジア地域に加え、欧州、北米、東南アジア・インドでの営業・サービス体制の充実を図っております。

今後も更なる業績の向上と業容の拡大を図り、企業価値を高めることで皆様のご期待にお応えする所存です。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売を行っております。当社の属する半導体製造装置業界には、シリコン（Si）を材料とした半導体製造装置を販売する企業は多く存在しますが、当社は全半導体製造装置市場の数パーセント程度の市場ですが成長が期待できるGaNやガリウムヒ素（GaAs）、SiCなどの化合物を主体材料とした化合物半導体製造装置に特化しております。

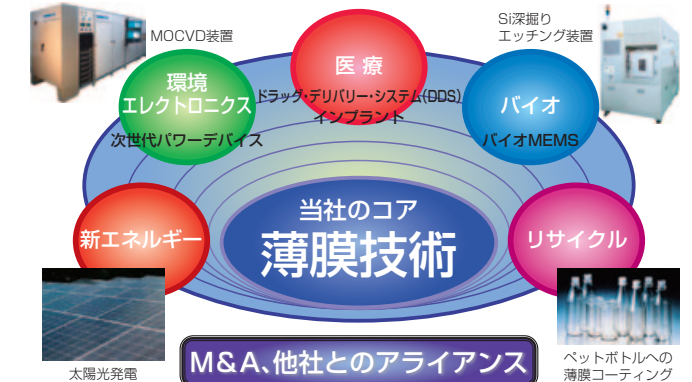
当社は、1979年9月の設立以来、『薄膜』を中核技術とした、材料開発と最先端のプロセステクノロジーの開発に注力してまいりました。化合物半導体には、Siにはない「発光する」「高い電子移動度」などの優れた特性があり、その『薄膜』用途は環境分野や医療分野など将来的にも無限の可能性を秘めております。

明確な戦略“非シリコン市場”



半導体と材料開発の分野で躍進する企業という意味を含めています。

持続的成長に向けた新規事業の開拓・育成



経営理念

薄膜技術で世界の産業科学に貢献する

当社は、薄膜を微細加工するエッチング装置、薄膜を形成するCVD装置、基板表面などをクリーニングする洗浄装置などの製造販売を行っております。これらの製品は、LEDや電子部品などの製造で重要な役割を果たしております。

微細加工分野



エッチング装置

各種半導体基板上的半導体薄膜、絶縁膜をはじめ微細加工が必要な材料をドライ加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻していくものです。ICP (Inductively Coupled Plasma=高密度プラズマ) を利用したエッチング装置は、高速で均一性に優れた加工が可能です。

取扱製品

- ・ICPエッチング装置
- ・リアクティブイオンエッチング装置



トルネードICP®
特許 第3790291号

トルネードICP®とは、サムコのプラズマに対する豊富な知識と経験から独自開発された誘導結合方式プラズマ源です。竜巻状に構成された特殊コイル電極が次世代プロセスに不可欠なエッチング技術を可能としました。

薄膜形成分野



CVD装置

反応性の気体を基板の上に堆積させる装置で、一般に半導体、電子部品製造のための半導体膜、絶縁膜、金属膜などを形成するために使われます。特にサムコは引火性のガスを使用せず、液体原料を活用したLS-CVD®装置 (LS=Liquid Source) に特徴があり、比較的低温反応で成膜速度が速く、均一性に優れた成膜が可能です。

取扱製品

- ・LS-CVD®装置
- ・プラズマCVD装置
- ・MOCVD装置



LS-CVD®装置の3次元LSIへの応用貫通ビア形成プロセスにおけるスルーホール内壁への絶縁膜の形成。アスペクト比の大きなスルーホールの側面、底面にもカバレッジに優れた絶縁膜の形成が可能です。

洗浄・表面処理分野

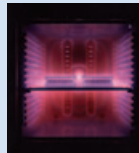


洗浄装置

サムコの装置は液体を使用しないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて洗浄するところに特徴があります。高速で自動運転が可能であるため、高集積化を要求されるフィルム状実装基板などにも使用されています。

取扱製品

- ・プラズマ洗浄装置
- ・UVオゾン洗浄装置



プラスチック基板のプラズマ処理プラズマ処理を行うことで表面が活性化し、ダイアタッチを改善します。また、ワイヤボンドの強度や封止のための接着強度を増大させます。

当社は、快適な暮らしを支える半導体や電子部品を加工するための装置を製造・販売しております。創業以来、研究開発を積極的に進め、斬新な製品群を世界中に提供してまいりました。蓄積した技術、アプリケーションは多岐にわたり、その分野を拡大しております。

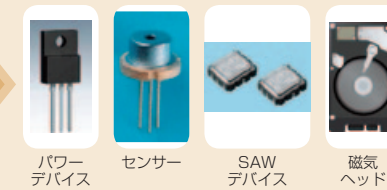
電子部品分野

パワーデバイス・高周波デバイス・各種センサー・MEMS・SAWデバイス・水晶デバイス・磁気ヘッドなどに関する分野です。これらは鉄道や自動車、産業機器、家電などで幅広く使われております。

使われるサムコの装置



作られる部品



最終製品



オプトエレクトロニクス分野

主に化合物半導体から作られるLEDやLDなどの発光デバイスのほか、電気信号を光信号にしたり、逆に光信号を電気信号にしたりする光通信デバイスなどに関する分野です。

使われるサムコの装置



作られる部品



最終製品



シリコン分野

ウエハー欠陥解析や三次元LSI・三次元パッケージなどに関する分野です。欠陥解析向けには、ICPエッチング装置やリアクティブイオンエッチング装置を提供しております。また、三次元LSI・三次元パッケージ向けには絶縁膜形成用プラズマCVD装置やSi深掘りエッチング装置、リアクティブイオンエッチング装置を提供しております。

実装・表面処理分野

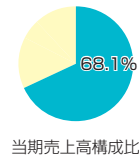
ICのパッケージングの洗浄や表面処理に関する分野です。高密度実装に対応するために基板はますます小型化、薄型化、多ピン化しており、高度な洗浄機能が要求されています。この分野にはプラズマ洗浄装置、UVオゾン洗浄装置を提供しております。

品目別販売状況

エッチング装置

売上高 **3,575百万円**
 前期比 **34.0%増**

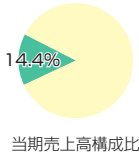
電子部品分野の生産用途向けの販売の急回復とオプトエレクトロニクス分野の生産用途向けの販売の堅調な推移により、売上高は3,575百万円となりました。



CVD装置

売上高 **758百万円**
 前期比 **43.4%増**

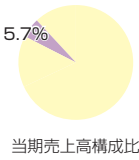
オプトエレクトロニクス分野と電子部品分野の生産機の販売が増加し、売上高は758百万円となりました。



洗浄装置

売上高 **298百万円**
 前期比 **23.6%減**

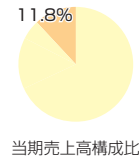
オプトエレクトロニクス分野と電子部品分野の販売は伸びましたが、実装・表面処理分野とシリコン分野が振るわず、売上高は298百万円となりました。



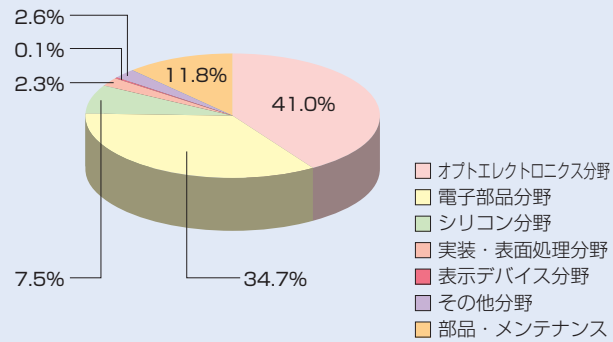
その他

売上高 **620百万円**
 前期比 **3.8%減**

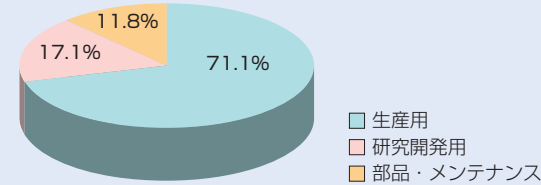
既存装置のメンテナンスや部品販売、装置の移設・改造作業などで、売上高は620百万円となりました。



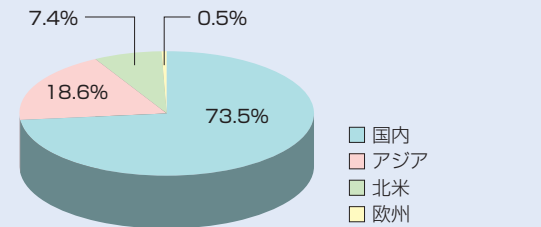
用途別売上高割合



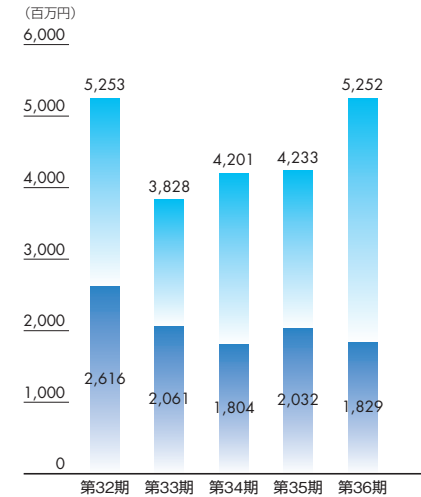
目的別売上高割合



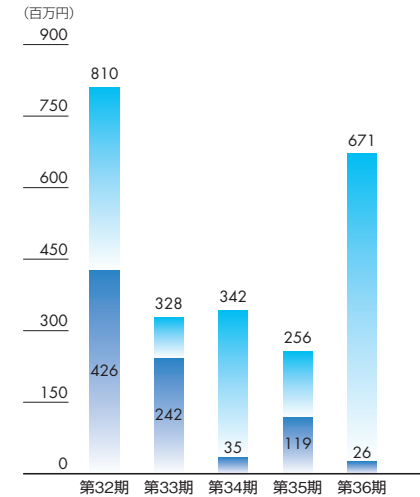
地域別売上高割合



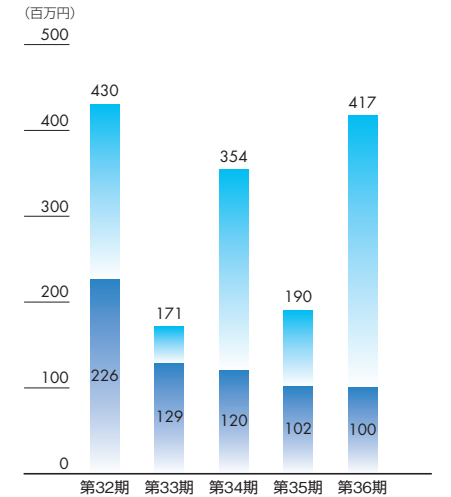
売上高



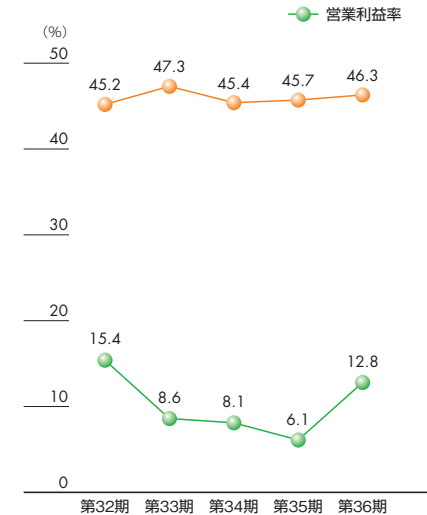
営業利益



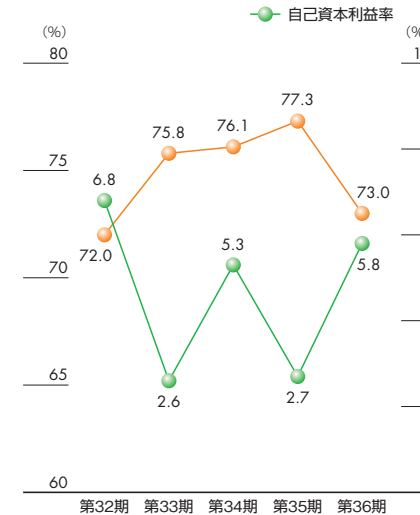
当期純利益



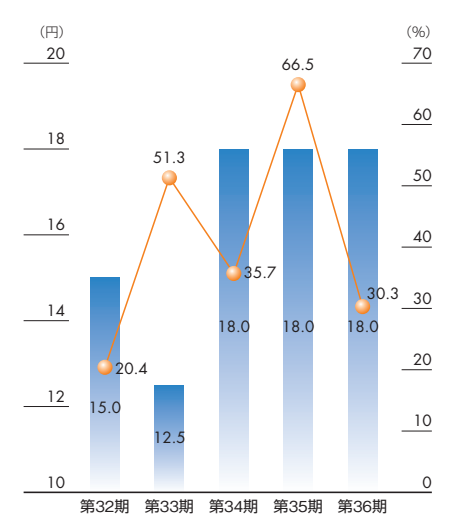
売上高総利益率・営業利益率



自己資本比率・自己資本利益率



配当金・配当性向



貸借対照表

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (平成27年7月31日現在)	前期 (平成26年7月31日現在)	科目	当期 (平成27年7月31日現在)	前期 (平成26年7月31日現在)
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	6,317,309	5,366,492	流動負債	1,985,346	1,394,810
現金及び預金	3,050,158	3,015,573	買掛金	685,564	366,953
受取手形	56,863	184,748	短期借入金	800,000	800,000
売掛金	2,377,932	1,686,512	1年内返済予定の長期借入金	—	16,685
たな卸資産	755,172	444,565	未払金	87,396	76,714
繰延税金資産	41,043	32,548	未払費用	34,610	33,629
その他	74,289	34,150	未払法人税等	219,000	19,000
貸倒引当金	△38,150	△31,606	未払消費税等	58,912	—
固定資産	3,630,821	3,700,169	預り金	32,187	25,751
有形固定資産	3,017,147	3,040,008	賞与引当金	25,800	24,800
建物	288,385	315,354	役員賞与引当金	14,340	3,690
構築物	2,268	2,802	製品保証引当金	22,100	20,300
機械及び装置	82,940	29,903	その他	5,436	7,287
車両運搬具	8,340	9,005	固定負債	697,906	664,833
工具、器具及び備品	7,901	11,236	退職給付引当金	341,404	309,043
土地	2,530,836	2,530,836	役員退職慰労引当金	337,410	332,456
リース資産	22,222	26,896	その他	19,090	23,333
建設仮勘定	74,251	113,973	負債合計	2,683,253	2,059,644
無形固定資産	12,892	15,259	(純資産の部)		
投資その他の資産	600,781	644,900	株主資本	7,182,472	6,892,254
投資有価証券	162,969	215,135	資本金	1,213,787	1,213,787
関係会社株式	40,254	40,254	資本剰余金	1,629,587	1,629,587
繰延税金資産	176,609	165,856	資本準備金	1,629,587	1,629,587
その他	220,947	223,654	利益剰余金	4,349,513	4,058,862
資産合計	9,948,130	9,066,662	利益準備金	59,500	59,500
			その他利益剰余金	4,290,013	3,999,362
			別途積立金	3,487,000	3,487,000
			繰越利益剰余金	803,013	512,362
			自己株式	△10,415	△9,982
			評価・換算差額等	82,405	114,763
			その他有価証券評価差額金	82,405	114,763
			純資産合計	7,264,877	7,007,017
			負債・純資産合計	9,948,130	9,066,662

損益計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (自平成26年8月1日 至平成27年7月31日)	前期 (自平成25年8月1日 至平成26年7月31日)
売上高	5,252,909	4,233,049
売上原価	2,819,699	2,297,941
売上総利益	2,433,209	1,935,107
販売費及び一般管理費	1,762,061	1,678,667
営業利益	671,148	256,440
営業外収益	165,792	50,381
営業外費用	8,006	14,385
経常利益	828,934	292,436
特別損失	139,873	—
税引前当期純利益	689,060	292,436
法人税、住民税及び事業税	266,853	118,034
法人税等調整額	4,944	△15,924
当期純利益	417,263	190,326

Point ▶ 売上高

電子部品分野のスマートフォン向け販売の回復により、売上高は前期比24.1%増の5,252,909千円。

国内の売上高は、スマートフォン向けとオプトエレクトロニクス分野の高輝度LED向けの販売が牽引し、前期比44.7%増で過去最高の3,861,455千円。

Point ▶ 販売費及び一般管理費

前期比5.0%増の1,762,061千円となったが、売上高の増加により販管費率は前期39.7%から当期33.5%へ6.2ポイントダウン。

Point ▶ 営業外収益

円安による外貨預金等の為替差益は前期の45,627千円から当期は158,402千円に拡大。

Point ▶ 特別損失

中国企業との間での設備売買契約の解除に伴う特別損失が139,873千円発生。

キャッシュ・フロー計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (自平成26年8月1日 至平成27年7月31日)	前期 (自平成25年8月1日 至平成26年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	167,621	△185,239
投資活動によるキャッシュ・フロー	△108,910	△300,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	△148,745	△174,745
現金及び現金同等物に係る換算差額	106,070	42,760
現金及び現金同等物の増減額	16,036	△617,719
現金及び現金同等物の期首残高	1,247,333	1,865,052
現金及び現金同等物の期末残高	1,263,370	1,247,333

Point ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー

プラス要因：税引前当期純利益689,060千円、仕入債務の増加318,611千円、減価償却費78,388千円、未払消費税等の増加58,912千円。
マイナス要因：売上債権の増加563,534千円、たな卸資産の増加310,606千円、為替差益125,743千円、法人税等の支払64,513千円。

Point ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー

プラス要因：定期預金の払戻による収入2,803,680千円。
マイナス要因：定期預金の預入による支出2,820,485千円、有形固定資産の取得による支出53,929千円、子会社への貸付けによる支出37,510千円。

Point ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー

マイナス要因：配当金の支払126,612千円、長期借入金の返済による支出16,685千円。

○生産能力拡大に向け第二生産棟（仮称）を新設



完成予想図

当社は、今後更なる需要拡大が見込まれる高周波デバイスやMEMS、次世代パワーデバイス向け製品の生産能力を増強するため、京都市伏見区の本社社屋の近接地に組立・調整・検査を目的とした新拠点（仮称 第二生産棟）の建設に着手しました。

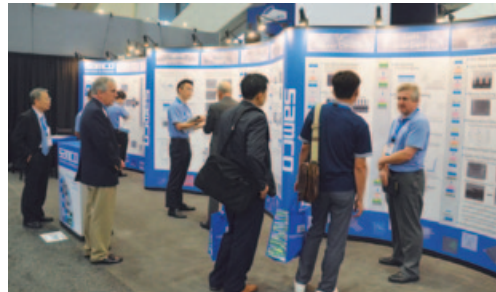
主に生産用途向け製造装置の組立・調整の拠点としての活用を計画しており、1,258m²の土地に簡易クリーンルームを備えた延床面積893m²の鉄骨平屋建工場を建設します。特に環境に配慮し、最先端の省エネ技術を導入したLED照明や一部電力を賄うための大型太陽光発電パネルを屋根全面に配置するほか、省エネ型新空調設備や廃水などを再利用するための冷却水循環装置も採用します。また、SiCなどを採用した省エネ受電設備の導入も検討しております。竣工は2016年5月末を予定しております。

当社は国内LEDメーカーから高輝度LED向けやスマホ用高周波デバイス向け生産機の設備投資を牽引役として、平成27年7月期には売上高前期比24.1%の成長を遂げております。また、国内のみならず円安に伴い北米を中心とする海外でもインターネット関連メーカーからの商談も増加しており、海外売上高比率も現在の26.5%から50%以上に高めようとしております。平成28年7月期から3年間の中期経営計画の推進による事業拡大で生産能力が限界の70億円程度に達する見込みであり、年間30億円程度追加の製品出荷が可能となる新拠点を建設いたします。

当社は3年後の売上高を現在の2倍以上にするという目標を掲げて事業展開しており、第二生産棟建設をその布石と位置付け、更なる成長を目指しております。

※第二生産棟の住所：京都市伏見区竹田藁屋町68番地、69番地

○海外の展示会に積極的に出展



セミコン・ウエスト2015（7月14～16日、サンフランシスコ）

当社は重点課題の一つに「海外三大市場（アジア、北米、欧州）での営業力強化」を掲げ、海外での拠点整備や人員強化、展示会への積極的な出展を行っております。平成27年7月期には、セミコン・ウエスト（米国）、セミコン・ヨーロッパ（仏国）、セミコン・チャイナ、セミコン・台湾などのセミコンショーをはじめ、化合物半導体分野のCS ManTech（米国）やMEMS分野のTRANSDUCERS（米国）など多くの海外の展示会に出展いたしました。

■ 会社概要

商号	サムコ株式会社
英文社名	SAMCO INC.
設立	昭和54年（1979年）9月
事業内容	半導体等電子部品製造装置の製造、販売及び輸出入
資本金	1,213,787,288円
従業員数	169名
本社	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36番地 TEL(075)621-7841 FAX(075)621-0936
国内拠点	本社（京都）、東京支店（東京）、東海支店（愛知）、つくば営業所（茨城）、福岡営業所（福岡）
海外拠点	米国（カリフォルニア・ニューヨーク）、台湾、シンガポール、中国（上海・北京）、韓国、ベトナム
研究拠点	本社研究開発センター（京都）、オプティクス研究所（米国）、英国ケンブリッジ研究所

■ 役員

代表取締役会長兼社長	辻 理
取締役副社長執行役員	石川 詞 念 夫
取締役常務執行役員	川 邊 史 山 葉 隆 久
取締役執行役員	竹之内 聡 一 郎
社外取締役	村 上 正 紀
常勤監査役	山 田 史 郎 辻 村 茂
社外監査役	木 村 隆 之
執行役員	小 林 弘 明 久 保 川 泰 彦 田 口 裕 之 関 仲 修 上 田 泰 照

■ 株式の状況

発行可能株式総数	14,400,000株
発行済株式の総数	7,042,881株
株主数	5,125名

■ 大株主の状況

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
辻 理	1,939,507	27.5
サムコエンジニアリング(株)	920,282	13.1
サムコ従業員持株会	216,738	3.1
辻 猛	205,215	2.9
辻 一美	201,465	2.9
(株)三菱東京UFJ銀行	129,600	1.8
京都中央信用金庫	120,000	1.7
立田 利明	103,899	1.5
三菱UFJキャピタル(株)	102,931	1.5
CBNY- GOVERNMENT OF NORWAY	102,780	1.5

■ 所有者別株式分布状況

